

THE SILICON PROCESS POSTER 2008 年度版の内容

1. 御社のロゴが入ったポスターを世界の半導体関係展示会で配布いたします。
2. www.techposter.com 内にて御社のロゴを掲載。
3. ホットスタンプポスター 100枚(*)の無料進呈。

(*)ホットスタンプポスターは、御社名・ご住所・お電話・FAX・WEB サイトが入ったポスターです。御社の宣伝ツールなどにお役立ていただけます。

ISSUE NO.	配布予定の展示会	ポスターの言語 / 配布予定数				料金のご案内		お申込み期限
		英語版	繁体字版 (中国語)	日本語版	簡体字版 (中国語)	料金 (1ロゴ/1スペース)	特別パッケージ	
1	Semicon West 07 Semicon Taiwan 07	35,000	—	—	—	US\$3,350 (US\$0.096 cost per unit)	US\$3,950 (1+1A) (US\$0.084 cost per unit)	31 st May 2007
1A	Semicon Taiwan 07	—	12,000	—	—	US\$1,950 (US\$0.162 cost per unit)		15 th Aug 2007
2	Semicon Europa 07 Semicon Japan 07 Semicon Korea 08	30,000	—	—	—	US\$2,950 (US\$0.098 cost per unit)	US\$3,950 (2+2A) (US\$0.088 cost per unit)	31 st Aug 2007
2A	Semicon Japan 07 Internecon Japan 08	—	—	15,000	—	US\$2,350 (US\$0.157 cost per unit)		15 th Nov 2007
3	Semicon China 08 Semicon Singapore 08	30,000	—	—	—	US\$2,450 (US\$0.082 cost per unit)	US\$2,950 (3+3A) (US\$0.080 cost per unit)	15 th Feb 2008
3A	Semicon China 08 Electronica/ Productronica China 08	—	—	—	12,000	US\$1,450 (US\$0.121 cost per unit)		15 th Feb 2008
	Subtotal	95,000	12,000	15,000	12,000			
	Total Circulation	134,000						
All English Version (Issue No. 1+2+3)						US\$8,750 (US\$0.092 cost per unit)	US\$5,950 (US\$0.063 cost per unit)	31 st May 2007
Full Coverage (All Issues)						US\$14,500 (US\$0.110 cost per unit)	US\$7,900 (US\$0.059 cost per unit)	31 st May 2007

お客様にてご用意頂くもの

1. 300dpi 以上の画像データ (JPG, GIF, AI など)
2. 御社情報 (英語)
会社名・ご住所・お電話・FAX・WEB サイト
3. ホットスタンプポスター用の情報 (英語)
会社名・ご住所・お電話・FAX・WEB サイト
(ホットスタンプポスターの文字の色につきましては、
GOLD 色・SILVER 色の 2 色からお選びいただけます。)



半導体プロセスポスターサンプル

下記のカテゴリから御社に適したカテゴリをお選びください。

- Wafer Fabs
- IC Design Company
- Associations & Trade Bodies

Wafer Manufacturing

- Crystal Growth
- Crystal Slicing
- Wafer Lapping and Polishing

IC Design & Mask Making

- Circuit Design
- Photomask Creation

Repeated Process Throughout Manufacturing

- Wafer Cleaning
- Wafer Defects Inspection

Wafer Processing (Front End Manufacturing)

- Epitaxy
- Oxidation
- Chemical Vapor Deposition
- Photoresist Coating
- Photolithography(Exposure)
- Development
- Etching
- Photoresist Stripping
- Diffusion/Implantation
- Metallization
- Thermal Processing
- Chemical Mechanical Planarization
- Wafer Metrology

Assembly, Packaging and Final Test (Back End)

- Wafer Probe and Test
- Passivation & Backgrinding
- Wafer Mounting & Dicing
- IC Mounting & Die Attachment
- Wire Bonding
- Encapsulation
- Marking, Lead Finish & Decoupling
- Burn-in-Test
- Electrical Characteristics Test
- Packing & Shipping

Supporting Facilities, Equipment Materials & Functions

- Cleanroom Technologies
- Factory Automation & Robotics
- EDA & Yield Enhancement Software
- Metals & Process Materials
- Process Materials, Gas & Water
- Environment, Health & Safety
- OEM Subsystems & Components

Paddlestone Pte Ltd

日本語サイト

<http://www.techposter.jp/>

英語サイト

<http://www.techposter.com/>